

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2023 年 3 月 9 日 (09.03.2023)



(10) 国际公布号
WO 2023/030119 A1

(51) 国际专利分类号:
G06F 16/903 (2019.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2022/114427

(22) 国际申请日: 2022 年 8 月 24 日 (24.08.2022)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202111007507.6 2021 年 8 月 30 日 (30.08.2021) CN

(71) 申请人: 北京北方华创微电子装备有限公司 (BEIJING NAURA MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.) [CN/CN]; 中国北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。

(72) 发明人: 柴加加 (CHAI, Jiajia); 中国北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。

(74) 代理人: 北京天昊联合知识产权代理有限公司 (TEE&HOWE INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS); 中国北京市东城区东长安街

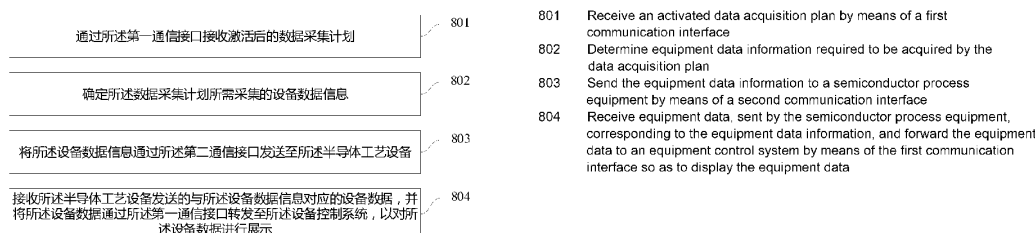
1 号东方广场东方经贸城西一办公楼 5 层 1, 6-12 室彭瑞欣, Beijing 100738 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

(54) Title: DATA ACQUISITION METHOD, DEVICE, AND SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR PROCESS EQUIPMENT

(54) 发明名称: 一种半导体工艺设备数据采集方法、装置和系统



(57) Abstract: A data acquisition method, device, and system for semiconductor process equipment. The method comprises: receiving an activated data acquisition plan by means of a first communication interface (801); determining equipment data information required to be acquired by the data acquisition plan (802); sending the equipment data information to the semiconductor process equipment by means of a second communication interface (803); and receiving equipment data, sent by the semiconductor process equipment, corresponding to the equipment data information, and forwarding the equipment data to an equipment control system by means of the first communication interface so as to display the equipment data (804).

(57) 摘要: 一种半导体工艺设备数据采集方法、装置和系统, 方法包括: 通第一通信接口接收激活后的数据采集计划 (801); 确定数据采集计划所需采集的设备数据信息 (802); 将设备数据信息通过第二通信接口发送至半导体工艺设备 (803); 接收半导体工艺设备发送的与设备数据信息对应的设备数据, 并将设备数据通过第一通信接口转发至设备控制系统, 以对设备数据进行展示 (804)。

[见续页]

WO 2023/030119 A1

本国际公布：

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。